

您設計產品時的好朋友！



Forum: EEPROM, NVM

Topic: 24LC08BHT-E/MNY DFN 包裝

Subject: Re: 24LC08BHT-E/MNY DFN 包裝

作者: Ryang

2018年04月02日 10:38:25

一般在 DFN 包裝是用來接地散熱用，但在這顆元件上沒有提到這 PAD 的接法。因為 24LC08 幾乎不會發熱，可以不用管這個 PAD。